

安集微电子科技（上海）股份有限公司

投资者关系活动记录表

股票简称：安集科技

股票代码：688019

编号：2026-010

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称	Allianz Global Investors, HK、东方红资管、富国基金、国金证券、建信基金、平安养老、浦银安盛基金、勤辰资产、瑞士百达、长江证券、招商基金、中银资管。
时间	2026年6月23日
地点	公司会议室
公司接待人员姓名	职工董事、副总经理、董事会秘书 杨逊 资深总办投关专员 周婷婷
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司介绍： 介绍公司经营业务及未来发展规划。</p> <p>二、问答环节主要内容： Q：公司近期公告筹划发行H股，想了解下本次筹划的背景和主要考虑，以及募投方向和时间节奏上是否有初步计划？ A：公司始终坚持“立足中国、服务全球”的战略定位，本次筹划发行H股，旨在打造国际化资本运作平台，借助国际资本市场拓宽多元化融资渠道，进一步提升公司综合竞争力和国际影响力，深入推进全球化战略布局。目前，公司发布了《关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告》，相关细节尚未确定，我们将依据相关法律法规和规范性文件的规定，根据本次H股发行上市的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请关注后续的披露信息。</p>

Q: 公司未来 3-5 年业绩增长的主要驱动力来自哪些方面?

A: 首先, 市场需求层面, 半导体先进制程的持续发展、产业链国产化替代的趋势, 以及下游客户产能扩张, 三者共同构成了强劲的外部驱动力; 其次, 业务拓展层面, 公司在深耕并巩固国内市场的同时, 稳健、有选择地探索海外市场机会, 同时持续加大研发投入、推动产品迭代与性能升级, 通过提升产品性能并拓展品类, 进一步巩固和扩大核心产品的市场份额, 开辟增量空间; 最后, 在增长模式上, 公司坚持以主营业务为核心的有机增长为主航道, 同时保持开放、审慎的态度, 积极关注能为公司长期发展创造价值的外延机会。

Q: 关注到近期部分原材料市场有涨价, 同时部分原材料供应链趋紧, 想了解下: 一是涨价对我们成本端及毛利率的影响, 二是供应紧张是否会对公司交付产生影响?

A: 目前来看原材料价格波动的传导相对有限, 成本端整体可控; 目前毛利率的变动主要取决于产品结构的动态变化及处于不同生命周期的产品市场定位调整, 具体以我们后续披露的定期报告为准。关于供应链情况, 公司一直高度关注原材料供应安全, 一方面与供应商保持长期稳定的合作关系, 争取更多的产能支持, 保障供应稳定; 另一方面, 公司为支持业务扩展、适应增长需求及提升供应链韧性, 适时安排战略库存储备, 目前整体生产交付平稳有序。

Q: 公司海外业务目前进展如何? 是否主要聚焦中国台湾地区?

A: 公司以“立足中国、服务全球”为核心战略定位, 秉持循序渐进、按需进展的策略, 稳健、务实地开展海外布局。公司积极拓展中国台湾地区的市场, 正从多个维度推进本地化能力建设, 逐步完善当地人才团队、实验室环境搭建, 加快当地化布局, 提升公司软硬能力; 并与客户积极立项, 紧密跟踪项目管理, 在技术合作项目、产品验证进程等方面均取得阶段性进展, 整体进度符合预期。与此同时, 公司也在同步推进新加坡等其他海外区域的布局, 海外业务整体稳步推进。

Q: 公司抛光液在国内主流客户中份额已较高, 未来增长是否主要依赖客户扩产?

A: 公司 CMP 抛光液产品的增长是多因素共同驱动的: 一是在客户端持续深耕, 随着产品在主要客户中的覆盖面和渗透度不断扩大, 叠加客户产能爬坡及扩产计划, 构成

了增长的基本盘。二是产品升级迭代，先进制程的不断演进带来新产品、新工艺、新应用的市场需求，公司持续加大研发投入，推动产品迭代与性能升级，以满足更高工艺节点的要求，凭借技术竞争优势进一步巩固和扩大市场份额。三是国产化替代仍有空间，在国内外资背景的芯片制造公司中，外资供应商仍占据一定份额，这也是公司持续努力的方向。与此同时，公司在深耕国内市场的同时，稳健、有选择地探索海外市场机会。经过不断深耕，公司化学机械抛光液全球市占率近三年从 8%提升至 13%（根据 TECHCET 全球市场规模测算），已跻身全球主流供应厂商行列。未来，公司会持续专注，争取在全球市场中赢得更多认可。

Q：公司定期报告中功能性湿电子化学品营收同比增速表现亮眼，电镀液及添加剂系列产品是否也归在该分类中？增长主要贡献来源哪类产品？

A：公司定期报告中功能性湿电子化学品大类主要包括刻蚀后清洗液、光刻胶剥离液、抛光后清洗液、刻蚀液等产品，2025 年该板块营业收入同比增长 63.73%，增长贡献主要来源于上述清洗类产品，是公司的第二增长曲线。电镀液及添加剂的营收也计入功能性湿电子化学品大类，目前收入贡献来说相对较小，但公司在持续加强集成电路制造及先进封装领域电镀液及添加剂产品系列平台的搭建，目前集成电路大马士革电镀液及添加剂已进入量产阶段，先进封装用电镀液及添加剂已有多款产品实现量产销售。

Q：目前看市场需求增长节奏很快，公司产能是否能匹配市场和客户的需求？

A：公司每年都有固定资产投资在生产线上，产能逐步爬坡，满足现有客户需求的同时适度预留产能空间，以应对市场和客户的增长需求。现有基地方面，上海金桥、宁波北仑基地扩展有序推进，多条新增产线已投产；上海化学工业区电子化学品专区制造基地主体建筑已封顶，为下一阶段提供产能保障。同时，公司通过优化空间布局、推进产线智能化改造，持续提升生产自动化与精细化水平。未来规划方面，公司秉持“小步快跑、滚动规划”的思路，以 3-5 年为周期研判行业发展，提前推进生产基地物理环境建设，持续跟踪市场发展，动态化灵活推进产线投资与产能爬坡，既保障稳定供货、承接新增需求，又避免盲目扩产导致资源闲置。

附件清单（如有）	无
日期	2026年6月25日